

NCS 기반 채용 직무기술서 [연구-1]

배치(예정) 본부 및 부서	자율제조연구소	전략분야 R&R	상위역할	4차 산업혁명 시대에 대응한 스마트 생산장비 혁신 선도
	반도체장비연구센터		주요역할	제조기술의 한계를 넘는 신개념 제조장비 개발
채용분야	첨단 칩렛 시스템 반도체 패키징 공정장비 핵심기술 개발			
NCS 분류체계	대분류	중분류	소분류	세분류
	NCS 미개발 분야			
연구원 주요사업	○ 기계 관련 미래 원천 기술, 산업 핵심 기술 및 사회 난제 해결 기술의 연구개발, 기계류·부품 공인시험 및 신뢰성 향상 기준·기술 개발 보급, 중소·중견기업 기술 지원 및 육성			
직무수행내용	○ 차세대 반도체 패키징 공정장비 및 스마트화 기술 개발 - 차세대 반도체·디스플레이 패키징 공정 설계를 통한 신공정 개발 및 검증 - 패키징 공정 신뢰성 평가 및 불량원인 분석(본딩, 배선, 특성 평가 등) - 데이터·시뮬레이션 기반 패키징 공정장비 분석, 모델링 및 최적화 - 패키징(조립, 핸들링, 가공, 검사, 몰딩 등) 장비 설계 및 스마트 제어기술			
전형방법	○ 1차 서류전형 → (2차 전형 생략) → 3차 종합면접 → 신원조사·합격자발표·신체검사 → 임용			
일반요건	연령	제한 없음		
	성별	제한 없음		
교육요건	학력	석사학위 이상 소지자		
	전공	기계공학, 메카트로닉스, 반도체/디스플레이 공학 등		
필요지식	○ 반도체 패키징 공정의 기본 원리와 최신 기술 동향 대한 전반적인 이해 ○ 반도체 패키징 관련 공정 소재에 대한 물리·화학적 특성 이해 ○ 반도체·디스플레이 패키징 장비(본더, 레이저, 이송·정렬 시스템 등)에 대한 전반적인 지식 ○ 패키징 공정 장비 분석을 위한 유한요소법에 대한 기본적인 이해			
필요기술	○ 반도체·디스플레이 패키징 공정 설계 및 평가 기술 ○ 반도체 패키징 공정예측 시뮬레이션 툴 (Abaqus, ANSYS, Python, MATLAB, COMSOL 등) 활용 기술 ○ 반도체 패키징 공정장비 개발에 필요한 핵심 모듈 설계 및 평가 기술 ○ 차세대 패키징 공정 관련 실험 장비 운영 기술 ○ 공정 조건을 반영한 장비 개발을 위한 데이터 수집 및 분석 기술			
직무수행태도	○ 창의적이고 도전적인 연구자세, 객관적인 판단력, 논리적 분석 태도 ○ 새로운 기술 지식을 탐구하려는 자세, 적극적인 업무 태도, 긍정적인 업무 태도 ○ 맡은 일을 끝까지 완수하는 책임감 있는 태도 ○ 조직의 일원으로 구성원과 융화하며 상호 협력하려는 자세 ○ 원칙을 준수하고 청렴하며 공정한 업무 처리 태도			
관련자격	○ 없음			
직업기초능력	○ 의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 자기개발능력, 대인관계능력, 정보능력, 기술능력, 조직이해능력, 직업윤리			
참고 사이트	○ www.ncs.go.kr 참조			

※ 직무기술서에 기술된 교육요건(전공), 필요지식 및 필요기술은 별도로 표기되어 있지 않는 한 1개 항목 이상 해당 시 지원 가능